

宣传用 Preview

Carrier显影Mechanism

正式 PDF 购买前预览

载体附着发生机理

载体附着发生机理

双组分显影系统中电气、磁性与显影剂条件综合技术书



技术标准 e-book / 中文版

原始技术书	07_Carrier显影Mechanism.pdf
原始页数	10
语言	中文
制作基准	保持原语言 / 宣传摘要 / 包含 History / 购买前预览

1. 为什么需要这本技术书

显影技术是将碳粉移动到潜像区域的核心成像工艺。本 Preview 把显影方式、碳粉带电量、Bias、辊/刮刀结构和不良机理连接起来说明。

- 核心关键词: Carrier、显影
- 原始正文以叙述方式说明设计变量、工艺条件、品质评价和不良原因之间的连接关系。
- Preview 只公开购买判断所需范围，详细数值、完整数据和实务条件保留为正式 PDF 的价值。

2. 核心内容摘要

- 技术功能目的与系统边界
- 设计变量与品质特性的因果关系
- 制造工艺中需要管理的 CTQ 与工艺条件
- 不良发生机理与预防观点
- 测量、验证和量产管理所需检查点

3. 技术 History 与产业背景

随着复印机和打印机对画质的要求不断提高，显影工艺从单纯供粉发展到同时管理 Q/M、薄层形成、显影间隙、Bias 波形和长期耐久性的综合技术。

技术开发观点

- 从经验式调整转向数据化标准设计
- 从单一零件管理扩展到系统相互作用管理
- 从初期性能满足转向环境变化与耐久后的稳定性管理
- 将开发、制造和检查基准连接为一个技术标准

5. 购买前可确认的价值

本 Preview 不公开正式版的全部细节，而是帮助购买者在购买前判断技术范围、学习价值和实际应用方向。

适用读者

打印机/复印机部件开发工程师，碳粉与卡匣工程师，制造技术与品质人员，工艺自动化及技术营业人员

4. 主要目录 Preview

以下仅展示正式 PDF 的部分主要章节结构。完整正文在购买后确认。

01	载体附着发生机理
02	双组分显影系统中电气、磁性与显影剂条件综合技术书
03	技术标准 e-book / 中文版
04	验证方法与质量管理要点
05	生因素。各章按照机理、设计意义、不良风险和验证方法展开。
06	本技术书将载体附着的 7 个关键因素分别说明，然后从设计和质量管理角度连接各因素之间的作用关系。
07	特别是把已确认的试验值、推荐管理范围和机理推定原因分开描述，使条件变更后能够形成可验证的判定
08	管理条件不能理解为“电位差越大越好”。基准中提出 ΔV 需要控制在 200 V 以下，推荐管理窗口为
09	但是在实际机器中，OPC 电位、Developer Bias 的极性、DC Bias 基准点以及曝光后的残余电位会共同
10	作用。因此 ΔV 计算必须使用统一的极性基准，只比较绝对值可能造成误判。质量判定时应同时记录电

正式 PDF 中可确认的详细项目

- 设计基准与适用范围
- 各功能部件的作用与相互作用
- 工艺条件和品质管理要点
- 不良原因解析与对策方向
- 试验方法、评价基准和验证顺序

Preview 公开限制原则

本 Preview 是在线销售用宣传资料。详细 Recipe、完整数据、定量条件和图纸级细节保留在正式 PDF 正文中。

- Preview 只包含核心摘要说明和代表性目录。
- 详细 Recipe、设计尺寸、定量工艺条件、成本计算和完整数据不在 Preview 中公开。
- 禁止未经授权的复制、再发布和商业性再利用。
- 正式 PDF 可用于教育、开发评审、制造技术标准化和品质改善。

购买者可以通过本 Preview 预先判断技术书的主题、难度、适用领域和实务价值。